

JIS

多層プリント配線板

JIS C 5014⁻¹⁹⁹⁴

(2004 確認)

平成 6 年 1 月 1 日 改正

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

主 務 大 臣：通商産業大臣 制定：昭和 63. 11. 1 改正：平成 6. 1. 1 確認：平成 11. 6. 20

官 報 公 示：平成 11. 6. 21

原案作成協力者：社団法人 日本プリント回路工業会

審 議 部 会：日本工業標準調査会 電子部会（部会長 多田 邦雄）

この規格についての意見又は質問は、経済産業省 産業技術環境局標準課 情報電気標準化推進室（〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3-1）にご連絡ください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第15条の規定によって、少なくとも5年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

多層プリント配線板

C 5014-1994

(1999 確認)

Multilayer printed wiring boards

1. 適用範囲 この規格は、主に電子機器に用いる多層プリント配線板(以下、プリント板という。)について規定する。ただし、多層フレキシブルプリント配線板、多層フレックスリジッドプリント配線板及びメタルコアプリント配線板には、適用しない。

備考1. この規格の引用規格を、次に示す。

JIS C 5001 電子部品通則

JIS C 5012 プリント配線板試験方法

JIS C 5603 プリント回路用語

JIS C 6480 プリント配線板用銅張積層板通則

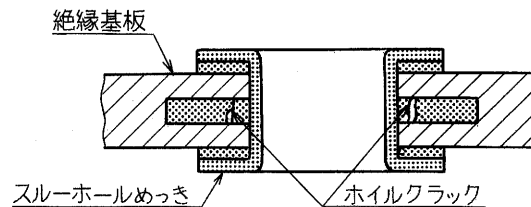
2. この規格の対応国際規格を、次に示す。

IEC 326-3(1991) Printed boards. Part 3 : Design and use of printed boards

IEC 326-6(1980) Printed boards. Part 6 : Specification for multilayer printed boards

2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は、JIS C 5001及びJIS C 5603の規定によるほか、次による。

- (1) 挿入実装 プリント板に設けた部品穴に、部品端子を挿入し、電気的接続を行う搭載方法。
- (2) ホイルクラック めっきスルーホールと接続する銅はくのスルーホールめっきの近傍に生じるき裂。



- (3) 基準マーク 正確なプリント板の位置を決めるために、プリント板の角に付けたマーク。
- (4) 部品位置決めマーク プリント板上の基準マークに対する部品の位置を決めるために設けたマーク。

3. 等級 この規格で用いるプリント板のパターンの微細度及び品質を表す等級は、次による。

また、これらの等級は、規定する個々の項目ごとに必要な等級を選択して使用する。

なお、クラス別に規定されていない箇所は、全クラスに適用する。

- クラス I 通常のレベルが要求されるもの。
- クラス II 高いレベルが要求されるもの。
- クラス III 特に高いレベルが要求されるもの。

4. 設計基準及び許容差